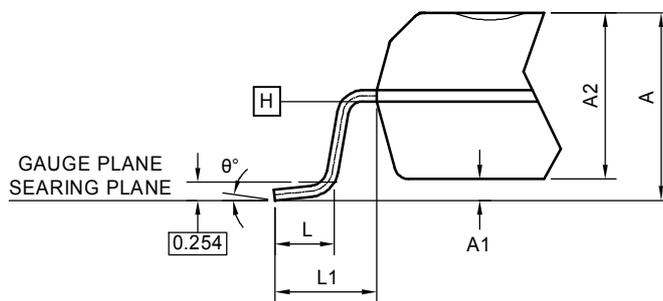
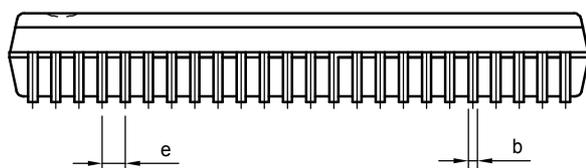
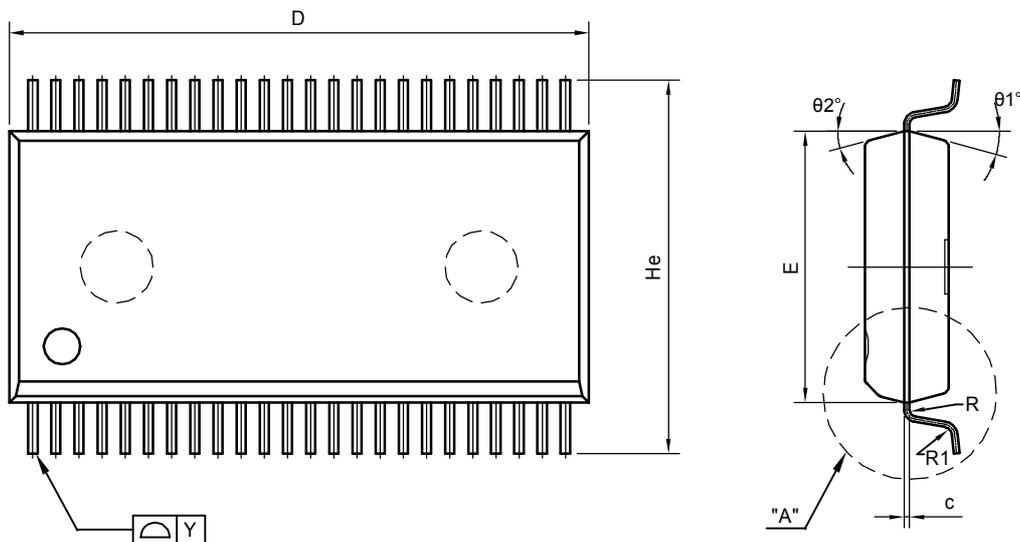




标注	尺寸	最小(mm)	标准(mm)	最大(mm)	标注	尺寸	最小(mm)	标准(mm)	最大(mm)
A		2.413	2.500	2.794	L		0.570	0.700	0.954
A1		0.103	0.200	0.306	L1		-	1.400	-
A2		2.159	2.300	2.413	Y		-	-	0.076
b		0.203	0.254	0.330	θ		0°	-	8°
c		-	0.152	-	θ_1		-	15° TYPE	-
D		15.698	15.850	16.002	θ_2		-	15° TYPE	-
E		7.391	7.500	7.595	R		-	0.20 TYPE	-
e		-	0.635	-	R1		-	0.25 TYPE	-
He		10.058	10.300	10.566					



DETAIL: A

未注尺寸公差	
x-----	±0.5
x.x-----	±0.1
x.xx-----	±0.01
x.xxx-----	±0.005

制图	黄乙为	2014/05/09	名称	生效日期		
审核	黄乙为	2014/05/09	0.635SSOP48 封装产品图	等级标记	重量	比例
批准						
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-OL-057	气派科技股份有限公司 CHINA CHIPPACKING TECH.CO.,Ltd		
			版次	A		